

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2018-041

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年6月27日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股权激励计划限制性股票预留部分登记工作。具体内容详见公司于2018年6月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公司编号：临 2018-033）。

2018年7月16日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

注册号：913200007746765307

名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司

法定代表人：王蔚

公司住所：苏州工业园区汀兰巷 29 号

注册资本：人民币 234,221,955 元

实收资本：人民币 234,221,955 元

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品，销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日